



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202492492 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220025793. 9

(22) 申请日 2012. 01. 19

(73) 专利权人 欣兴同泰科技(昆山)有限公司
地址 215316 江苏省苏州市昆山市汉浦路
999 号

(72) 发明人 李年 朱东锋 唐俊龙 赵小爱

(74) 专利代理机构 上海思微知识产权代理事务
所(普通合伙) 31237

代理人 郑玮

(51) Int. Cl.

C09J 7/02 (2006. 01)

C09J 9/02 (2006. 01)

H05K 3/00 (2006. 01)

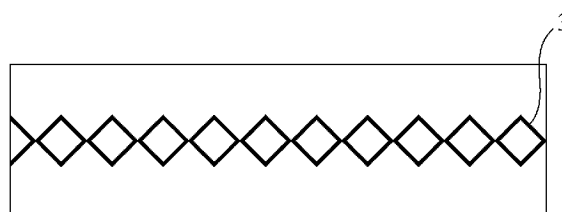
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

胶带

(57) 摘要

本实用新型提供一种胶带,其用于粘合批量生产的柔性电路板,所述胶带包括胶带主体和导电胶,所述导电胶印制于所述胶带主体的胶面上,所述导电胶呈网格状分布,本实用新型中提供的胶带是在原有的用于保护柔性电路板的覆盖膜的胶面上,印制了一层导电胶,这层导电胶呈网格状分布于所述覆盖膜的胶面上,覆盖膜的胶面能够从网格状的导电胶间露出,在保留了胶带原有的粘合功能的前提下,该胶带还能够通过导电胶起到导电效果,这使得在柔性电路板的卷式生产时,能够将由该胶带粘合而组成的电路板卷整体放入电镀铜缸中,进行一次性镀铜工作,大大提高了柔性电路板的生产效率及质量。



1. 一种胶带,用于粘合批量生产的柔性电路板,其特征在于,包括胶带主体和导电胶,所述导电胶印制于所述胶带主体的胶面上,所述导电胶呈网格状分布。
2. 根据权利要求 1 所述胶带,其特征在于,所述胶带主体包括聚酰亚胺层和胶合剂层,所述胶合剂层覆盖于所述聚酰亚胺层上。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述胶带,其特征在于,所述导电胶为银浆。

胶带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电路板的生产工艺,尤其涉及一种胶带。

背景技术

[0002] 图 1 为传统胶带的结构示意图,如图 1 所示,传统的胶带都是由聚酰亚胺层 1 和胶合剂层 2 组合形成的,胶合剂层 2 覆盖于聚酰亚胺层 1 上,使胶带既能够通过聚酰亚胺层 1 防止外界物质损坏胶合剂层 2 使其不失去粘性,又能够通过胶合剂层 2 起到粘合的作用,但是在卷式生产批量的柔性电路板时,若使用这种传统的绝缘胶带粘合批量的柔性电路板使其首尾相连组成电路板卷,则在后续的沉铜工艺时,便不能够使电路板卷的整体全部导电,即不能够一次性进行该电路板卷的电镀工作,严重影响了卷式生产中柔性电路板的生产质量及效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种胶带,其用于粘合批量的柔性电路板以实现整块电路板卷的一次性镀铜工艺。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种胶带,其用于粘合批量生产的柔性电路板,所述胶带包括胶带主体和导电胶,所述导电胶印制于所述胶带主体的胶面上,所述导电胶呈网格状分布。

[0005] 进一步的,所述胶带主体包括聚酰亚胺层和胶合剂层,所述胶合剂层覆盖于所述聚酰亚胺层上。

[0006] 进一步的,所述导电胶为银浆。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0008] 本实用新型中提供的胶带是在原有的用于保护柔性电路板的覆盖膜(Coverlayer)的胶面上,印制了一层导电胶,这层导电胶呈网格状分布于所述覆盖膜的胶面上,覆盖膜的胶面能够从网格状的导电胶间露出,在保留了胶带原有的粘合功能的前提下,该胶带还能够通过导电胶起到导电效果,这使得在柔性电路板的卷式生产时,能够将由该胶带粘合而组成的电路板卷整体放入电镀铜缸中,进行一次性镀铜工作,大大提高了柔性电路板的生产效率及质量。

附图说明

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

[0010] 图 1 为传统胶带的结构示意图;

[0011] 图 2 为本实用新型实施例提供的胶带的主视图;

[0012] 图 3 为本实用新型实施例提供的胶带的俯视图。

[0013] 在图 1 至图 3 中,

[0014] 1:聚酰亚胺层;2:胶合剂层;3:导电胶。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型提出的胶带作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。

[0016] 本实用新型的核心思想在于,提供一种胶带,其用于粘合批量生产的柔性电路板,所述胶带包括胶带主体和导电胶,所述导电胶印制于所述胶带主体的胶面上,所述导电胶呈网格状分布,本实用新型中提供的胶带是在原有的用于保护柔性电路板的覆盖膜(Coverlayer)的胶面上,印制了一层导电胶,这层导电胶呈网格状分布于所述覆盖膜的胶面上,覆盖膜的胶面能够从网格状的导电胶间露出,在保留了胶带原有的粘合功能的前提下,该胶带还能够通过导电胶起到导电效果,这使得在柔性电路板的卷式生产时,能够将由该胶带粘合而组成的电路板卷整体放入电镀铜缸中,进行一次性镀铜工作,大大提高了柔性电路板的生产效率及质量。

[0017] 请参考图2和图3,图2和图3分别为本实用新型实施例提供的胶带的主视图和俯视图。

[0018] 本实用新型实施例提供一种胶带,其用于粘合批量生产的柔性电路板,所述胶带包括胶带主体和导电胶3,所述导电胶3印制于所述胶带主体的胶面上,所述导电胶3呈网格状分布。

[0019] 进一步的,所述胶带主体包括聚酰亚胺层1和胶合剂层2,所述胶合剂层2覆盖于所述聚酰亚胺层1上。

[0020] 进一步的,所述导电胶3的制作材料为银浆,银是良好的导体,将网格状的银浆印制在胶带主体(即覆盖膜)的胶面上能够大大加强该胶带的导电性。

[0021] 本实用新型中提供的胶带的制作方法为:

[0022] 步骤一:将卷装的覆盖膜(Coverlayer)材料取出,将其裁切成若干片状的材料,将这些片状的覆盖膜作为胶带主体。

[0023] 步骤二:撕去该若干片状覆盖膜上的离型纸,使这些覆盖膜均露出胶面。

[0024] 步骤三:在所述若干覆盖膜的胶面上均印制一层导电胶3,这层导电胶3呈网格状分布于所述若干覆盖膜的胶面上。

[0025] 步骤四:将所述若干片状覆盖膜剪成宽度合适的条状,用于粘合批量的柔性电路板。

[0026] 本实用新型中提供的胶带是在原有的用于保护柔性电路板的覆盖膜(Coverlayer)的胶面上,印制了一层导电胶3,这层导电胶3呈网格状分布于所述覆盖膜的胶面上,覆盖膜的胶面能够从网格状的导电胶间露出,使该胶带在保留了胶带原有的粘合功能的前提下,还能够通过导电胶3起到导电效果,这使得在柔性电路板的卷式生产时,能够将由该胶带粘合而组成的电路板卷整体放入电镀铜缸中,整组电路板卷一次性进行镀铜,大大提高了柔性电路板的生产效率及质量。

[0027] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变形而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

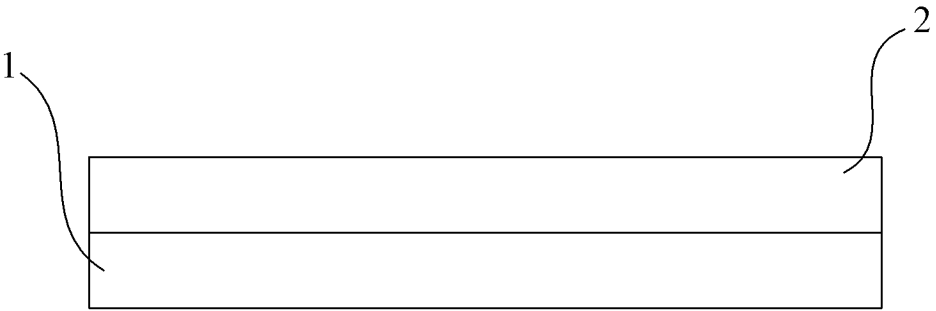


图 1

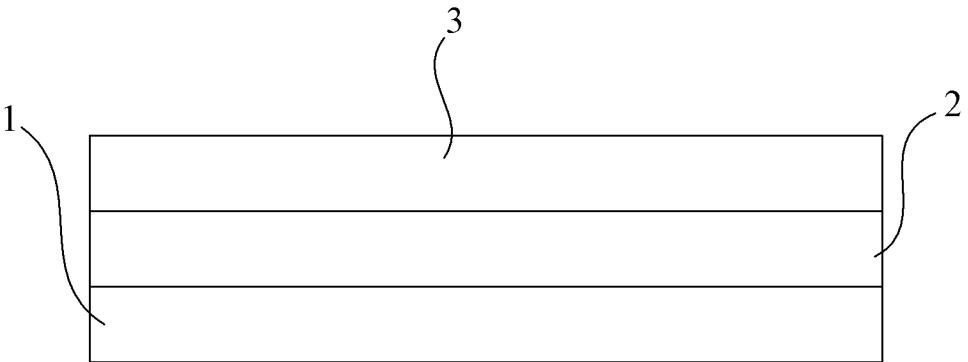


图 2

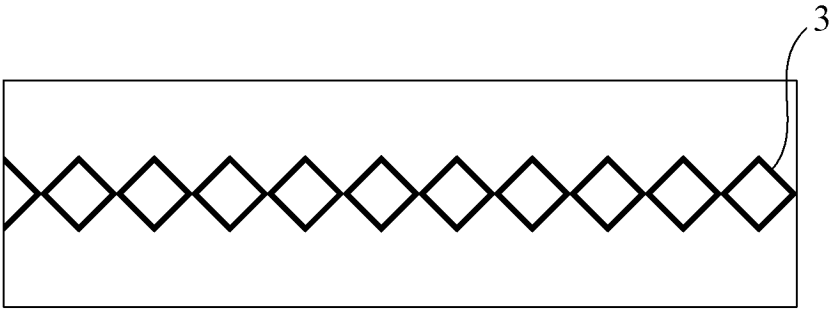


图 3